

10月29日(木) 14:00-16:40

セッションチェアマン： 森川 泰宏(株)アルバック)・藤原 健典(東レ(株))

◆ 技術とトレンド・マーケについて(仮題)



株式会社 SBR テクノロジー
代表取締役
西尾 俊彦

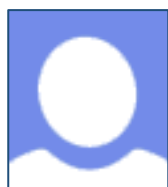
[講演要旨]

[講演者プロフィール]

- 1988 年：日本 IBM(株)半導体研究所
- 1993 年：同上 1 先端実装技術アプリケーション開発
- 2003 年：IBM Distinguished Engineer (技術理事)
- 2011 年：STATSChipPAC Ltd.
- 2013 年：同日本法人代表
- 2016 年 1 月：株式会社 SBR テクノロジー 設立

◆ 次世代 AI アクセラレータの技術フロンティア

—先端パッケージング、熱設計、CPO によるシステム統合進化—



3DIC リサーチラボ合同会社
リサーチ&コンサルティング
テクニカル・ディレクター
市川 公也

[講演要旨]

生成AIの普及により、AI半導体の課題はGPU単体の演算性能から、HBMのメモリ帯域、チップ間通信、電源供給、冷却を含むシステム全体の最適化へと移りつつある。本講演では、CoWoSなどの先端パッケージ

グ技術、液冷・Direct-to-Si冷却、さらにCPO（Co-Packaged Optics）による光電融合までを俯瞰し、次世代AIシステムを支える実装技術の最前線と今後のロードマップを解説する。

[講演者プロフィール]

市川公也は、Intel、日亜化学工業、TSMC Japan 3DIC R&D Centerにおいて、フリップチップ実装、有機ビルドアップ基板、EMIB、micro-LED実装、CoWoSを含む先端半導体パッケージング技術の研究開発・サプライヤー連携に従事してきた。TSMC Japan 3DIC R&D Centerでは、Technical DirectorとしてPost-5G事業に関連するHPC向け先端パッケージ材料・実装技術開発を主導し、2024年9月より現職の3DIC Research Lab LLCにて、AI/HPC向け2.5D/3D実装、先端パッケージング、熱設計、CPO/光電融合技術に関する技術コンサルティングを行っている。

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【D-2】光電融合

【D-3】先端 PKG